



LOTPASTE SC TH4N/NN

Wasserlöslich

Die Lotpaste SOLDER CHEMISTRY SC TH4N/NN ist ein high-tech Produkt, dessen Flussmittelrückstände nach dem Löten auf dem DCB oder Semiconductor Elementen leicht und nur mit reinem Wasser ohne jegliche Zusätze restlos entfernt werden können. Die Paste wurde im Hinblick auf die hohen Anforderungen unserer Kunden in der **Halbleiterproduktion** entwickelt

Die SC TH4N/NN ist eine bleihaltige Lotpaste, die absolut keine Lot- oder Flussmittelspritzer oder Lotkugeln beim Löten verursacht, und das unabhängig vom Lötverfahren oder angewandten Lötprofil.

Sie wurde auch speziell für fine-pitch Leiterplatten und SiP-Leadframes entwickelt. Sie bietet hervorragende Benetzungseigenschaften auf Silber- und Goldsubstraten und Cu/OSP-Oberflächen und das unter Stickstoff und Normalluft.

Die SC TH4N/NN ist eine homogene Mischung aus einem organischen Flussmittel (RE L0) und einem Lotpulver, das in allen Legierungen und Korngrößen geliefert werden kann.

- *SC TH4N/NN* Weicher, nur mit Wasser restlos entfernbarer Rückstand
- *SC TH4N/NN* Lange Standzeit, sehr resistent gegen Luftfeuchtigkeit
- *SC TH4N/NN* Sehr lange Klebezeit
- *SC TH4N/NN* Exzellente Benetzung - keine Lötperlen und Lunker
- *SC TH4N/NN* Geeignet für alle Pulverkorngrößen

PHYSIKALISCHE DATEN

<u>Bevorzugte Legierungen</u>	Schmelzpunkt	Lieferbare Korngrößen bzw. Pulverklassen
10Sn/88Pb/2Ag	267-290°C	Kl.3 (T3) 25 - 45 µm
Sn5Pb92,5Ag2,5	287-296°C	Kl.4 (T4) 20 - 35 µm
Sn2/Pb/Ag2.5	299-304°C	Kl.5 (T5) 10 - 25 µm

VISKOSITÄT (Pa.S) □ 10% gemessen mit Brookfield RVT-DV II Viskosimeter mit 90% Metallgehalt:

<u>Viskosität:*</u>		Konturenstabilität – DIN 32513 Sofort und 20min 80°C		Solderballing nach IPC	Benetzung nach IPC
600 Pas	Pulverklasse III	Kl.1 = 0,2	0,2	1	1
650 Pas	Pulverklasse IV	Kl.2 = 0,2	0,3		

OBERFLÄCHENWIDERSTAND (SIR) und elektrolytische Korrosionswirkung DIN32513

Die Werte von S.I.R. entsprechen denen vom Träger der Leiterplatten, da die Flussmittelrückstände völlig und restlos nur mit Wasser ohne Zusätze entfernt werden können!

QUALIFIKATIONEN

Die Lotpaste SCTH4N/NN ist eine sogenannte wasserlösliche Paste, die die höchsten Anforderungen auf diesem Gebiet in Erfüllung bringt. Der Korrosions-, Lotkugel- und der Benetzungstest sowie die Konturenstabilitätsprüfung wurden bestanden. Laboruntersuchungen bestätigen korrosionsfreie, der RE L0 (F-SW 33) entsprechende, Rückstände, die **wegen ihrer Wasserlöslichkeit ausnahmslos von der Leiterplatte entfernt werden müssen!!!**

VERBRAUCHERHINWEISE

Nach Entnahme der Paste, das Gebinde möglichst dicht verschließen. Die benutzte Paste soll nicht mit der frischen zusammen aufbewahrt werden. Im laufenden Arbeitsprozess darf selbstverständlich neue Paste der älteren zur Auffrischung zugeführt werden. Verschiedene Lotlegierungen und Pastentypen sollte man nicht vermischen.

Empfohlene Rakelgeschwindigkeit: 15 – 100 mm/s.

Merke! Der Pastendruker ist immer schneller als der schnellste Bestücker in der Linie. Das Wichtigste ist, daß die Paste beim Drucken am Rakel abrollt.

Für Schablonendruck wird eine Paste mit 90% Metallgehalt empfohlen.

Die Reinigung der Schablone kann mit nur Wasser oder einer Alkoholmischung erfolgen, aber das Reinigungsmedium darf unter keinen Umständen mit der Paste in Verbindung kommen. Die Lotpaste ist mit allen gängigen Reflow-Systemen aufschmelzbar.

LAGERUNG

Ungeöffnetes Gebinde – Dosen(!) bei ca. 20°C (RT): 6 Monate

Im geöffneten Zustand bzw. am Rakel der Druckeinrichtung ist die max. Verarbeitungszeit, abhängig von den Umwelteinflüssen denen die Paste ausgesetzt wird. **Eine Lagerung im Kühlschrank ist nicht notwendig!**

WASCHHINWEIS !

Das Flux unserer SC 111 ist vor und nach dem Löten **biologisch völlig abbaubar! Die Belastung des Abwassers , z.B. nach dem Gebrauch von 5 kg der SC 111, ist geringer als ein einziger Waschvorgang in einem durchschnittlichem Haushalt.**

So bestellen Sie Ihre Solder Chemistry Paste:

<u>Legende</u>	<u>Pastentyp</u>	<u>Korngröße</u>	<u>Legierung</u>	<u>Flußmittelanteil</u>
<u>Gebindegröße</u>				
z.B. 500g	TH4N/NN	T3	Sn10/Pb/Ag2	10%

Bestellbeispiel nach DIN:

Lotpaste (SC...) L-Sn10Pb88Ag2/ 1.2.3.C / 90 - 3 500g (Gebinde)

Solder Chemistry ; Fragnerstraße 4 ; D-84034 Landshut

Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020

E-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.solderchemistry.com

Vorstehende Angaben sollen sie bestmöglich informieren. Eine Verbindlichkeit kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, Anwendungen und Arbeitsprozesse, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte und Verpflichtungen Dritter, nicht übernommen werden